

臺灣半導體產學研發聯盟

A+A' 產學桂冠計畫架構

109年配合科技部REAL計畫推薦作業流程與注意事項

一、計畫簡介

臺灣半導體產學研發聯盟(TIARA, Taiwan IC Industry and Academia Research Alliance) 為產、學、研單位機構等團體會員共同組成之立案非營利社團法人，其主要任務為促進我國半導體科技領域之產學合作，以及鼓勵人才投入博士級高階研發工作。

TIARA 推動產學桂冠計畫架構(另稱 A+A' 計畫架構)，其【A計畫】為企業會員出資與學界合作共同開發業界需求之競爭前(pre-competitive)產業技術，並於計畫中同時培育博士級研發人才；【A'計畫】則由政府加碼補助，針對已形成或即將形成【A計畫】之學界團隊，進行與【A計畫】主題相關的前瞻學術研究。

109年科技部產學研發聯盟合作計畫(REAL, REsearch ALLiance)(即【A'計畫】)已於108年8月23日正式公告徵求。TIARA 為協助計畫推薦機構之一，作業流程與注意事項請參考本文件內容。

二、申請資格(非TIARA會員亦可提出申請)

經企業與合作學術研究單位(以下簡稱學研界)議定研發主題並簽署合作意向(或已有產學合作合約書)者，依科技部公告之申請書範本填具並附相關文件，由符合科技部補助資格之學界計畫主持人向 TIARA 提出申請。如為多家企業共同與學界合作，提出申請時，須包含各家企業出資經費及成果歸屬等約定之說明。

三、研發範疇

晶片設計、製造、封裝及測試等產業及其應用、軟體、平台、系統與材料、設備、設計自動化等領域所需之競爭前先導前瞻產業技術，以增加產業未來競爭力為目標，屬於高風險、高創新或需長期研發之先期研究計畫。

四、計畫內容

【A計畫】內容須符合《臺灣半導體產學冠桂計畫作業要點》及《臺灣半導體產學冠桂計畫作業辦法》之規範，敬詳附錄一及附錄二。重點摘述如下：

1. 【A計畫】可為一對一、一對多或整合型計畫，期程以多年期為原則，執行期間如進度或成果不符預期，得經產學團隊合作雙方自行協議啟動計畫退場機制或終止執行，唯【A'計畫】補助經費之處置依補助機關規定辦理。
2. 【A計畫】研究主題、方向及內容為機密資訊，產學團隊雙方及 TIARA 負妥善保守相關資訊之責任，參與計畫及相關作業人員均應簽署保密切結書。
3. 【A計畫】應有博士生或博士後研究人員參與，並得支領研究津貼（計畫是否有博士生參與為政府補助【A'計畫】審查評分項目之一）。
4. 【A計畫】研發成果以雙方均等共有為原則，且參與之各方均可基於該研發成果，各自獨立延伸發展相關技術及專利，且出資企業享有購買該研發成果完整權利之優先權。

【A'計畫】內容悉依補助機關之公告辦理。109年科技部產學研發聯盟合作計畫（REAL, REsearch ALLiance）公告網址：[【請按我請往】](#)

五、作業時程（共四階段）

1. 【申請】配合科技部109年作業時程，TIARA 自即日起受理申請，申請機構學界計畫主持人須依科技部公告相關附件詳實填寫，於108年09月26日前以電子郵件寄送至 TIARA 收件信箱：tiaratwic@gmail.com，並請來電確認收件情形（03-5753926）。
2. 【初審】TIARA 收件後進行文件初審，文件不符或有缺漏將通知補件，申請機構計畫主持人應於通知後三個工作日內完成補件，逾期不予受理並註銷申請。
3. 【書審】TIARA 進行書面審查，經審查後如需補充有關資料或進行其他說明，將回復審查意見並通知補件，申請機構應於通知後七個工作日內完成補件，未補件或補件後複審未通過者不予推薦。
4. 【核證】經書審（含複審）通過者，TIARA 最遲於科技部受理申請截止日七個工作日前寄發認可推薦證明。

六、經費編列與動支原則

1. TIARA 產學桂冠計畫建議【A計畫】與【A'計畫】之經費比例以六比四（6:4）為原則。

2. 【A計畫】經費之編列及運用，由產學團隊合作雙方自行協議，唯參與計畫博士生研究津貼，每名每月以不低於新臺幣二萬元為原則。
3. TIARA 與會員學校均已簽署合作意向書，校方同意《臺灣半導體產學冠桂計畫經費管理辦法》之範圍，請與校方或 TIARA 洽詢。
4. 【A'計畫】申請經費之編列與動支，悉依補助機關之公告辦理。

七、計畫執行與管考

1. 【A計畫】於執行期間由產學團隊合作雙方自行管考。
2. 獲【A'計畫】補助者，除【A計畫】合作約定書外，學研機構另應自行完成政府補助計畫相關合約之簽訂，其獲政府補助部份之管考，由學研機構依政府專案計畫之規範辦理。
3. 【A計畫】與【A'計畫】執行期間如遇管考事項疑異，歡迎洽詢或委託 TIARA 確認及協調。

※臺灣半導體產學研發聯盟辦公室

聯絡人：林雅庭秘書／電話：03-5753926／E-mail：ytlin@tiara.org.tw

※科技部專案補助計畫聯絡窗口：

科技部產學研發聯盟合作計畫辦公室

聯絡人：賈明蓉小姐／電話：02-27377204／E-mail：mjchia@stpi.narl.org.tw

科技部產學及園區業務司

承辦人：余懿珊小姐／電話：02-27377241／E-mail：ysyu@most.gov.tw